
南亞電路板股份有限公司 線上法說會

2022年1月26日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

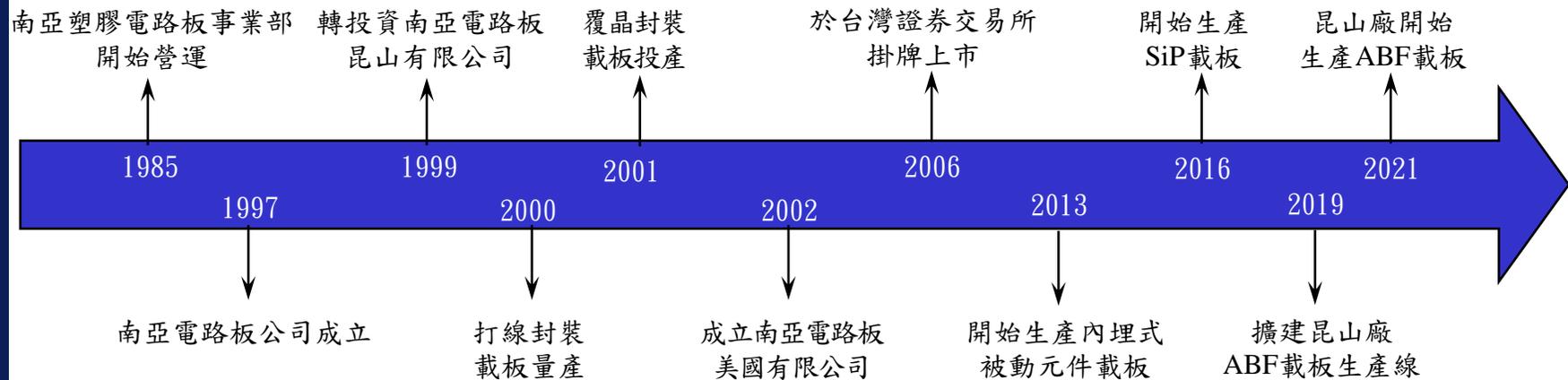
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2021年合併營業額為新台幣522.2億元
- 台股上市市值：新台幣3,696.0億元(2021年12月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革

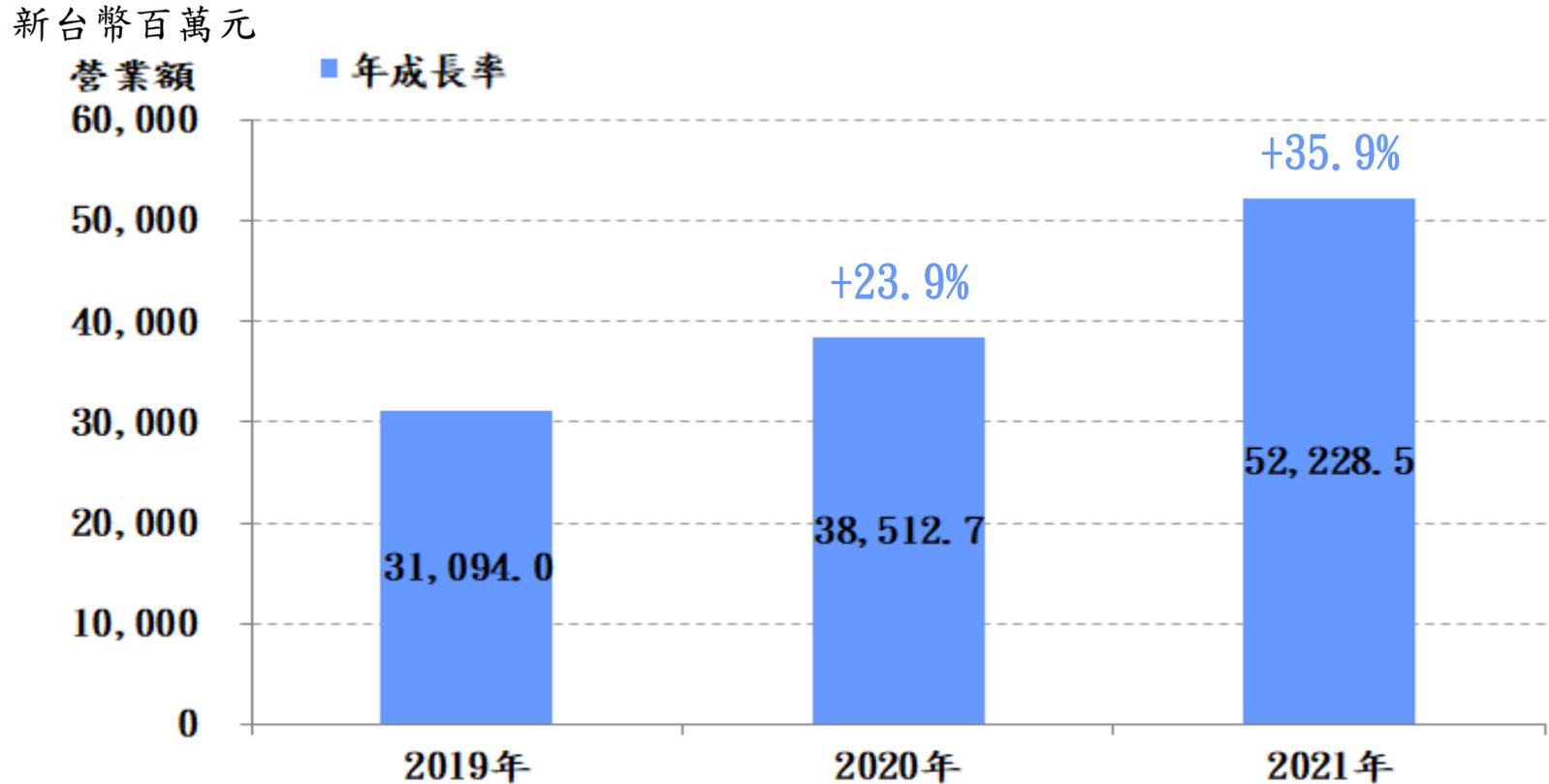


- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板



財務狀況

近三年合併營業收入(IFRS)



■ 2020年營收較2019年增加23.9%:

本公司提早佈局高階網通與系統級封裝載板等高值化產品市場，受益於客戶需求提升，2020年營收比2019年顯著成長。

■ 2021年營收較2020年增加35.9%:

本公司因高階電腦、網通、人工智慧及高效運算等應用產品銷售增加，IC載板需求續旺，2021年營收持續大幅成長。



財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

20,000

15,000

10,000

5,000

0

■ 季成長率

2021年第一季

2021年第二季

2021年第三季

2021年第四季

10,855.8

12,484.9

14,113.7

14,774.0

+15.0%

+13.0%

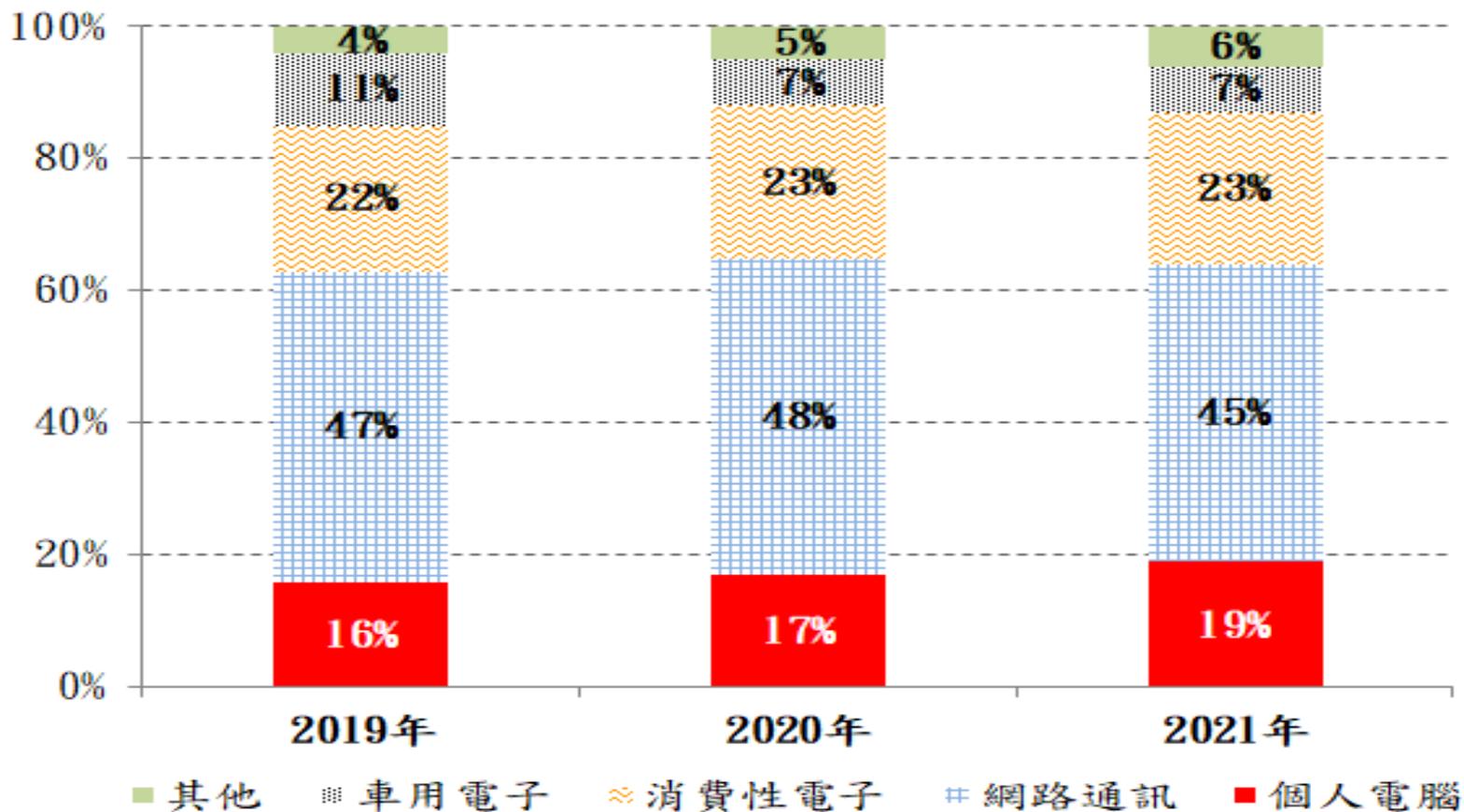
+4.7%

- 2021年第二季營收較2021年第一季增加15.0%:
第二季因高值化產品銷售增加與IC載板新產能挹注，營收比第一季成長。
- 2021年第三季營收較2021年第二季增加13.0%:
第三季受益於高值化產品比重持續提升與傳統銷售旺季，營收比第二季再成長。
- 2021年第四季營收較2021年第三季增加4.7%:
第四季因高階IC載板銷售持續強勁，營收繼續成長，營運表現淡季不淡。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

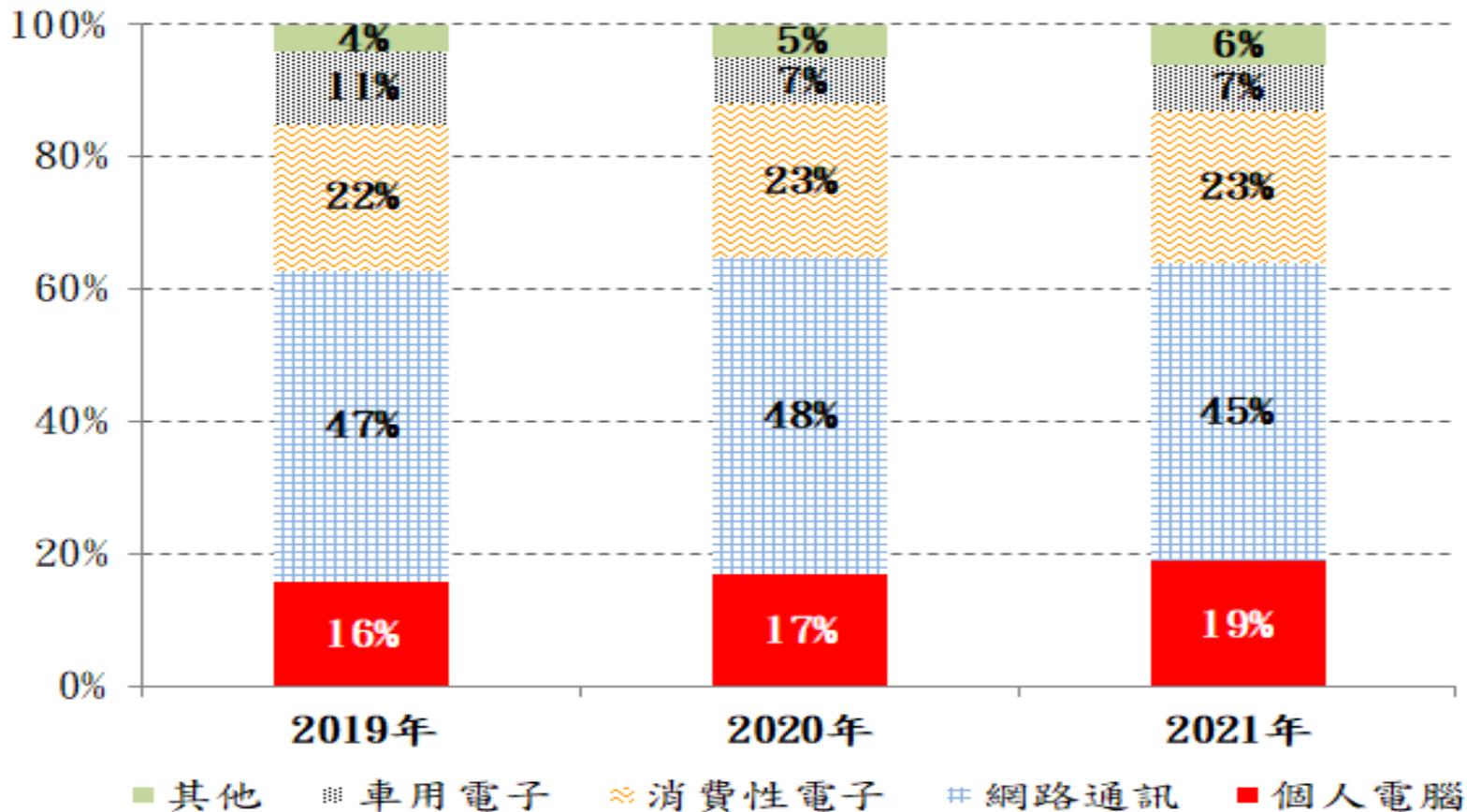


- 本公司個人電腦受益於資料中心、遠距商務及居家娛樂需求增加，2021年電腦應用產品營收比重比2020年增加。
- 因基地台需求受疫情影響而遞延，致2021年網通應用產品營收比重比2020年減少。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 2021年消費性與汽車應用產品營收比重持平，但公司營收顯著成長，因此消費性與汽車應用產品銷售金額仍比2020年增加。
- 本公司積極爭取人工智慧與高效運算等高值化產品訂單，2021年相關應用產品營收比重持續提升。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ 高階ABF載板

2022年除將與客戶緊密合作，持續開發高階電腦、網通、人工智慧及高效運算應用載板外，台灣廠將持續優化先進製程，生產高層數、大尺寸及細線路產品；昆山廠則量產更多成熟產品，藉由成本優勢，爭取更多產品商機，且依進度擴建兩岸產能，以進一步擴大市佔率。

■ SiP載板

因IC異質晶片封裝發展趨勢不變，系統級封裝(SiP)技術已大量應用在各項行動裝置，本公司將持續增加新世代穿戴裝置、高階5G手機相機、天線模組(AiP)及光學感應器等SiP載板，並切入AR與VR應用，未來SiP載板銷售量將持續增加。

■ 高密度連接板(HDI)

伴隨行動裝置、消費性及車用電子等產品設計愈趨精密，高值化之HDI使用量持續增加，本公司將持續增加高階HDI產品比重，以因應終端電子產品需求成長。



未來營運目標

營運管理方針

- 培養優秀的研發與製程技術人才，再強化研究開發量能，增加產品附加價值。
- 參與客戶設計，共同開發及提供原生數據，分享生產資訊，縮短交期。
- 持續針對2.5D/3D先進封裝趨勢發展，開發更多高階IC載板，以提升高值化產品銷售比重。
- 持續將人工智慧導入營運管理模式，推動智能化生產，並優化製程條件與設備效能，以軟硬並進的策略，提升良率與效率。
- 本公司將持續擴充高階IC載板產能，依計畫如期完成產能擴建：
 - 樹林廠ABF載板第一期擴建：2023年第一季投產
 - 昆山廠ABF載板第二期擴建：2023年第一季投產
 - 樹林廠ABF載板第二期擴建：2024年第一季投產
- 持續推動ESG專案，訂定國際科學基礎減碳目標，落實企業社會責任。



感謝您的聆聽

